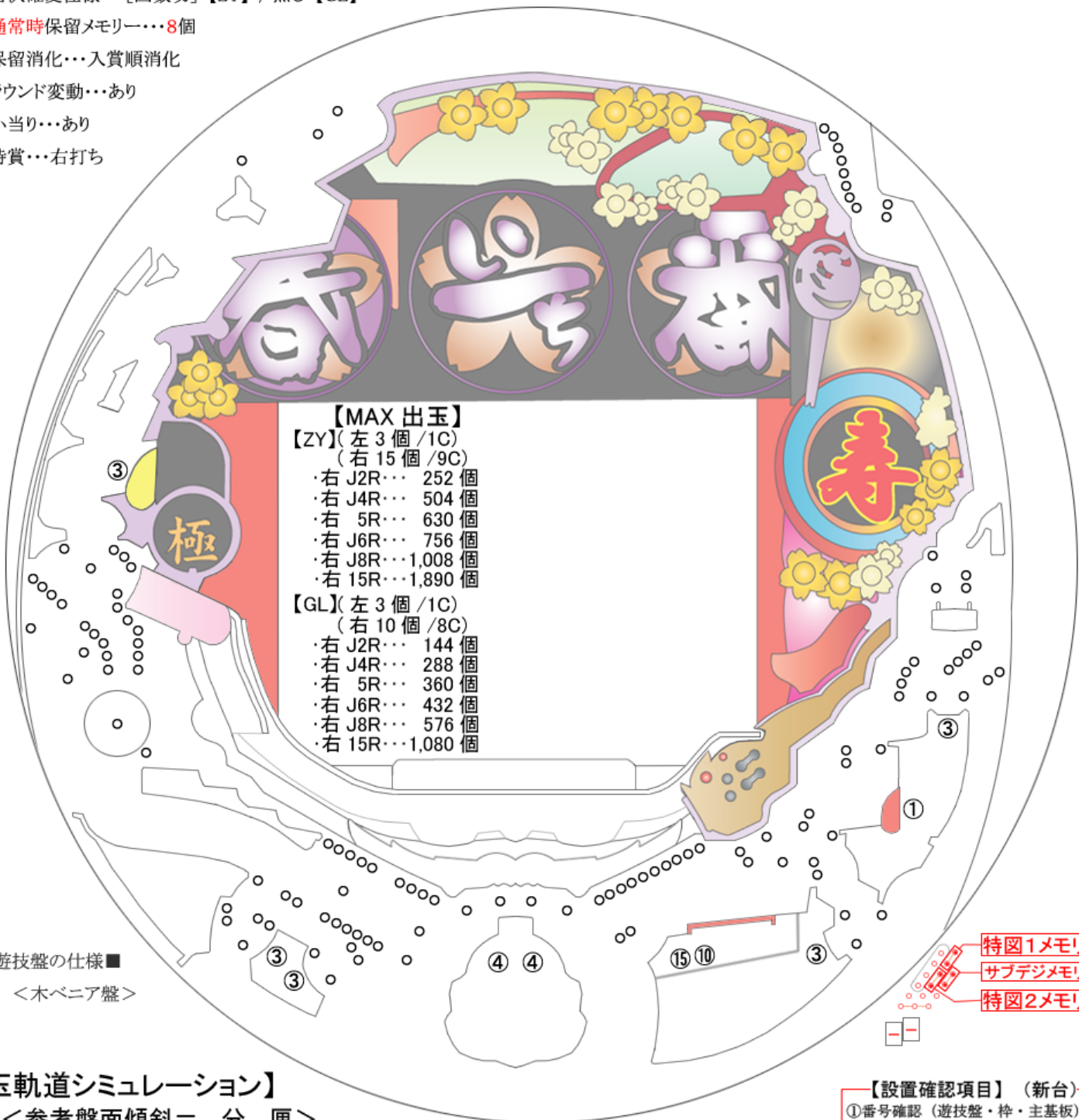


【ZY】 確率=1/319.7 確変=72.0%(ST=100)  
電サポ=・ST中 / 50/100回・通常後 / 50/100回 賞球=4&1&3&3&15  
【GL】 確率=1/79.92 確変=100.0%(ST=50) 電サポ=ST中 / 50回 賞球=4&1&3&3&10

- 機種タイプ…**変則ST【ZY】 / フルST【GL】**
- 潜伏確変仕様…[回数切] 【ZY】 / 無し 【GL】
- 通常時保留メモリー…8個**
- 保留消化…入賞順消化
- ラウンド変動…あり
- 小当り…あり
- 特賞…右打ち



■遊技盤の仕様■  
＜木ベニア盤＞

特図1メモリー  
サブデジメモリー  
特図2メモリー

【玉軌道シミュレーション】  
＜参考盤面傾斜 = 分 厘＞

- 【設置確認項目】(新台)
- ①番号確認 (遊技盤・枠・主基板)
  - ②主基板 (かしめ・封印シール)
  - ③払出基板 (ケース破損・開封)
  - ④その他基板 (破損・開封・コネクタ)
  - ⑤遊技釘・風車 (本数・形状・材質)
  - ⑥発射装置 (実発射にて確認)
  - ⑦払出装 (実入賞の払出にて確認)
  - ⑧図柄作動確認 (液晶・メイン・サブ)


- 【点検確認】(部品)
- A : 製造番号・番号票の点検**  
1:遊技盤番・2:枠・3:主基板
  - B : 主基板等の点検**  
4:主基板のケース異常・開封  
5:主基板の形状異常・異物  
6:払出基板のケース異常・開封  
7:払出基板の形状異常・異物  
8:ロムの形状・装着異常
  - C : 形状異常・異物の点検**  
9:周辺基板・10:中継端子板  
11:外部端子板・13:コネクタ  
12:ユニット接続端子板・14:配線  
15:裏パック・16:遊技くぎ及び風車  
17:上下皿
  - D : 発射装置の点検 (確認)**  
18:タッチセンサー作動確認  
19:発射個数・20:球飛び位置
  - E : 遊技基本動作の点検 (確認)**  
21:入賞賞球数・22:最大入賞数  
23:役物作動・24:図柄表示作動
  - F : その他の点検**  
25:全ての接続箇所点検  
26:スピーカーの作動確認  
27:各種ランプの点灯確認